

2018年5月30日更新

IMS2018に出展いたします

2018年6月12日(火)～6月14日(木)3日間、ペンシルベニアベンションセンター(アメリカ、ペンシルベニア州フィラデルフィア)にて、無線通信の専門展示会であるIMS2018に出展いたします。

◆会期 : 2018年6月12日(火)～6月14日(木) 3日間

◆会場 : ペンシルベニアベンションセンター(アメリカ、ペンシルベニア州フィラデルフィア)

◆当社ブース : 2153

フロアマップ <https://www.expocadweb.com/18ims/ec/forms/attendee/indexTab.aspx>

◆主な展示内容 :

【ヒートシンク製品】

・Ag-Diamond

特徴 : 600W/mK以上の熱伝導率を有する次世代ヒートシンク材料。銅よりも膨張係数は小さく、800°Cの一般銀ロウ付けも可能な耐熱性も有しています。

用途 : 高性能セラミックスパッケージのベース材、SiC/GaN高性能デバイスの放熱基板

・CPC

特徴 : Cu-Mo複合材の上下にCu層を備えた積層構造の複合材料。芯材となるCu-Mo材の組成と積層比率の組合せで、熱伝導率と線膨張係数を変えられます。

両表面がCuであるため、初期の熱放散性に優れています。

またAgろう付けが可能です。

用途 : 携帯電話基地局のアンプ用基板

※ 『IMS 2018』の概要は、主催者のオフィシャルホームページをご覧ください
→<https://www.ims2018.org/>



The 2018 IEEE MTT-S

International Microwave Symposium

10-15 June 2018 Philadelphia, PA

/